

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2026-069

金风科技股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十一次会议、2024 年年度股东会审议通过《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，根据股东会的授权，公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的长期限含权中期票据。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 27 日、2026 年 4 月 25 日在指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）披露的相关公告。

2026 年 7 月 15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN538 号），同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》的要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，在规定的有效期内，择机发行本次中期票据，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日